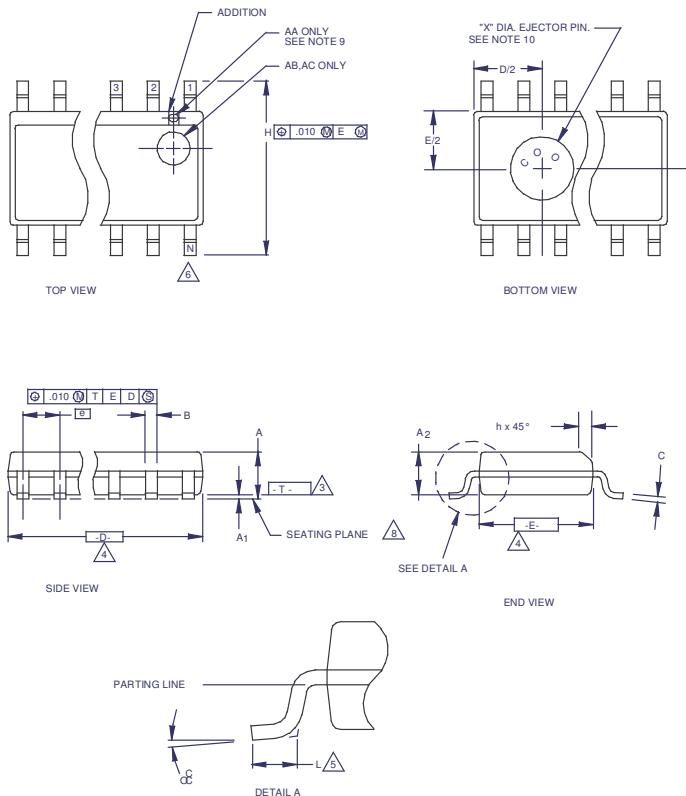




TSic™ Chip und Gehäuse Spezifikationen für TSic™ Temperatursensor IC Technische Daten

1 TSic™ SOP-8 Gehäuse-Abmessungen

Die folgenden Mass-Zeichnungen sind für die TSic™ Serie SOP-8 Gehäuse (SOIC Narrow, 0.150).
Siehe **Tabelle 1.1** und **Tabelle 1.2** auf der nächsten Seite für die Abmessungen in den Zeichnungen.
Abmessungen sind in Zoll, wo nicht anders angegeben.



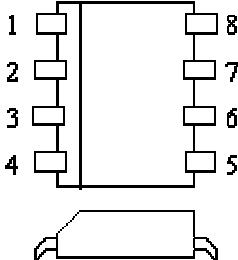
Bemerkungen:

1. Maximal erlaubte Chip Dicke 0.015.
2. Abmessungen und Toleranzen:

Dezimal	Winkel	dritte Winkelprojektion
.xx ± 0.01"	±1°	
.xxx ± 0.002"		
.xxxx ± 0.0010"		

3. "T" ist ein Referenzdatum.
4. "D" & "E" sind Referenz-Messwerte und beinhalten keine Schweiß-Nähte oder Vorsprünge. Jedoch sind Schweißversätze inbegriffen und sind gemessen an der Schweiß-Trennlinie. Schweißnähte und Vorsprünge sollten nicht grösser sein als 0.006 Zoll am Ende (Side View rechts) und 0.01 Zoll am Ausschnitt.
5. "L" ist die Länge der Anschlüsse fürs Löten auf ein Substrat.
6. "N" ist die Nummer der Anschluss-Position.
7. Anschluss-Positionen sind nur als Referenz gezeigt.
8. Geförnte Anschlüsse sind untereinander auf 0.03 Zoll planar.
9. Das Aussehen der Marke für Pin 1 ist optional rund oder rechteckig.
10. Herstellerland-Position auf dem Gehäuseboden ist optional und hängt vom Gehäuse-Lieferanten ab.
11. Masseinheit: Zoll.
12. Dieses Gehäuse ist konform mit JEDEC Standart MS-012, Variation AA, AB & AC.

SOP-8 Pin Verteilung



Pin	Name	Beschreibung
1	V+	Supply voltage (3.0-5.5V)
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal
4	Gnd	Ground
3, 5-8	TP/NC	Test pin / NC Do not connect



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY



TSic™ Chip und Gehäuse Spezifikationen für TSic™ Temperatursensor IC Technische Daten

TSic™ SOP-8 Gehäuse-Abmessungen (Fortsetzung)

Tabelle 1.1 – TSic™ SOP-8 Gehäuse-Abmessungen in Zoll

	Gebräuchliche Abmessungen			Bem.	Bemerkung	3			S		
	MIN	NOM	MAX			Variationen	D			B	
							MIN	NOM			MAX
A	0.061	0.064	0.068		AA	0.189	0.194	0.196	8		
A1	0.004	0.006	0.0098		AB	0.337	0.342	0.344	14		
A2	0.055	0.058	0.061		AC	0.386	0.391	0.393	16		
B	0.0138	0.016	0.0192								
C	0.0075	0.008	0.0098								
D	siehe Variationen			3							
E	0.15	0.155	0.0157								
e	0.050 BSC										
H	0.23	0.236	0.244								
h	0.01	0.013	0.016								
L	0.016	0.25	0.035								
N	siehe Variationen			5							
	0°	5°	8°								
X	0.085	0.093	0.1								

Tabelle 1.2 – TSic™ SOP-8 Gehäuse-Abmessungen in Millimeter

	Gebräuchliche Abmessungen			Bem.	Bemerkung	3			S		
	MIN	NOM	MAX			Variationen	D			B	
							MIN	NOM			MAX
A	1.55	1.63	1.73		AA	4.8	4.93	4.98	8		
A1	0.127	0.15	0.25		AB	8.58	8.69	8.74	14		
A2	1.4	1.47	1.55		AC	9.8	9.93	9.98	16		
B	0.35	0.41	0.49								
C	0.19	0.2	0.25								
D	siehe Variationen			3							
E	3.81	3.94	3.99								
e	1.27 BSC										
H	5.84	5.99	6.2								
h	0.25	0.33	0.41								
L	0.41	0.64	0.89								
N	siehe Variationen			5							
	0°	5°	8°								
X	2.16	2.36	2.54								

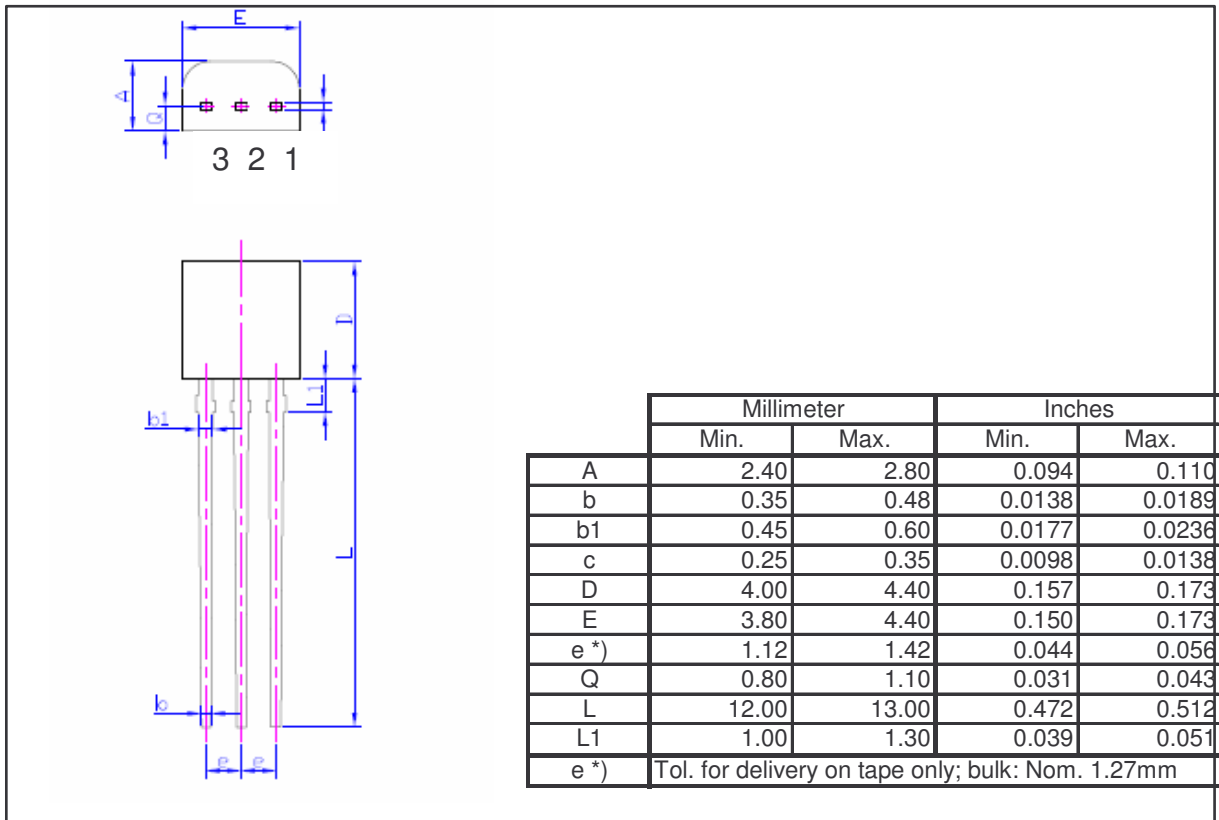


INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY



TSic™ Chip und Gehäuse Spezifikationen für TSic™ Temperatursensor IC Technische Daten

2.1 TSic™ E-Line Gehäuse-Abmessungen



E-Line Pin-Zuordnung

Pin	Name	Beschreibung
3	V+ (VDD)	Speisespannung (3.0-5.5V)
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal
1	Gnd (VSS)	Masse (Ground)



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY



TEMPERATUR



FEUCHTE

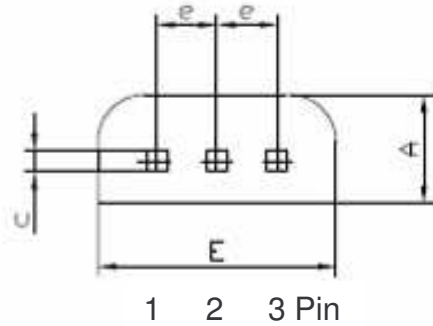


STRÖMUNG

TSic™ Chip und Gehäuse Spezifikationen für TSic™ Temperatursensor IC Technische Daten

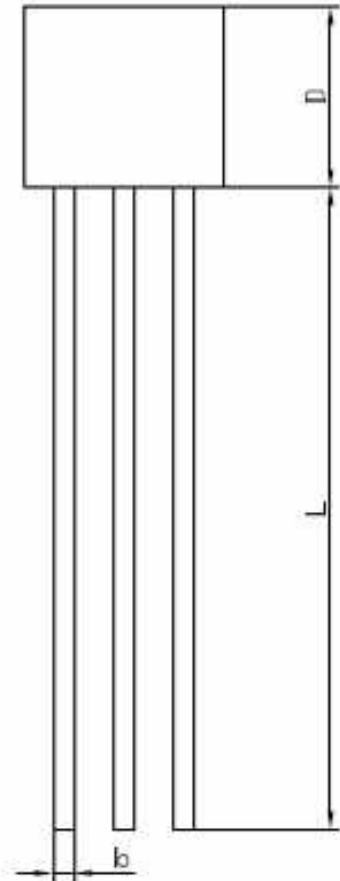
2.2 TSic™ TO92 Gehäuse-Abmessungen

Dim.	Millimeter		Inches	
	min.	max.	min.	max.
A	2.16	2.41	0.085	0.095
b	0.41	0.495	0.016	0.0195
c	0.41	0.495	0.016	0.0195
D	3.61	4.01	0.14	0.16
E	4.37	4.77	0.172	0.188
e	NOM. 1.27		NOM. 0.05	
L	13.0	13.97	0.512	0.550



TO92 – Pin-Zuordnung

Pin	Name	Beschreibung
3	V+ (VDD)	Speisespannung (3.0-5.5V)
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal
1	Gnd (VSS)	Masse (Ground)



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY



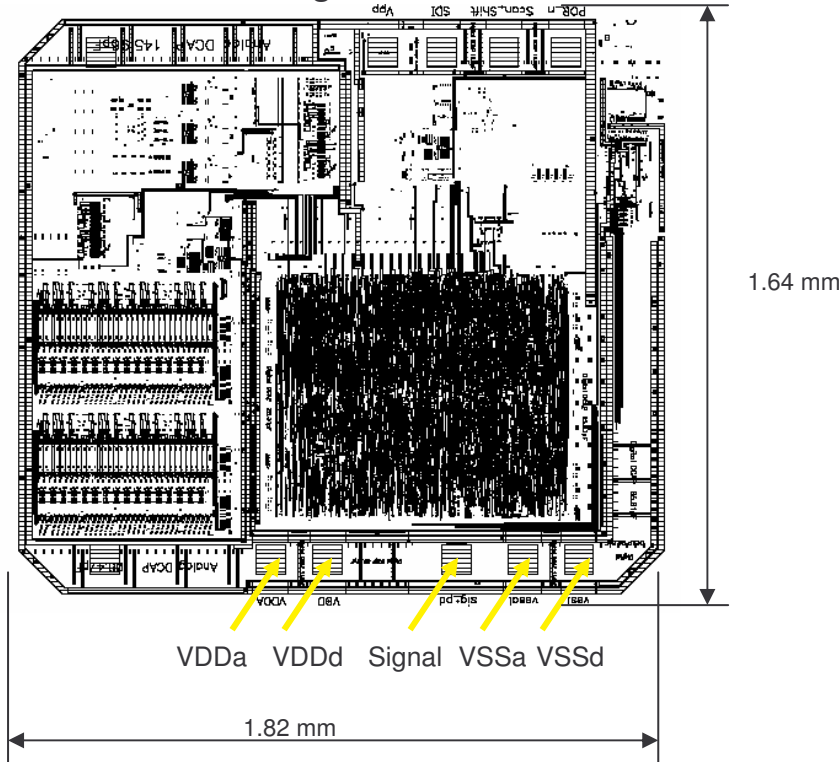
TSic™ Chip und Gehäuse

Spezifikationen für TSic™

Temperatursensor IC

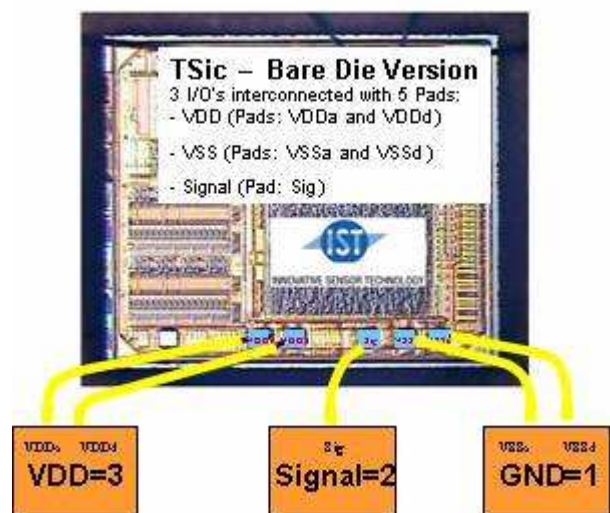
Technische Daten

3 Bare-Die Abmessungen



Bare-Die Pin-Zuordnungen

Pin	Name	Beschreibung
3	V+ (VDD)	Speisespannung (3.0-5.5V)
2	Signal	Temperatur Ausgangssignal
1	Gnd (VSS)	Masse (Ground)



Der analoge und digitale Anschlusspad VSSa und VSSd werden zusammengeschlossen zu GND. VDDa und VDDd werden zusammengeschlossen zu VDD. Das Signal benötigt nur ein Wirebond.



INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY

